2026年11月10日

各　位

会 社 名　　株式会社フジミインコーポレーテッド
代表者名　　代表取締役会長　関　　敬 史
（コード番号　５３８４　東証プライム、名証プレミア）
問合せ先　　財務本部長　　川 島　敏 裕
（TEL 052-503-8181）

「中長期経営計画2026」詳細版の公表について

2027年3月期を初年度とする6ヵ年経営計画（以下、本計画）の詳細資料を公表いたします。
なお、本計画の定量面につきましては、2026年10月9日に公表済です。

（注）将来に関する記述等についての注意事項
当資料に記載の業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいたものであります。従いまして、実際の業績等は、諸々の要因により見通し等とは異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。

以　上

中長期経営計画2026
（2027年３月期～2032年３月期）

株式会社フジミインコーポレーテッド

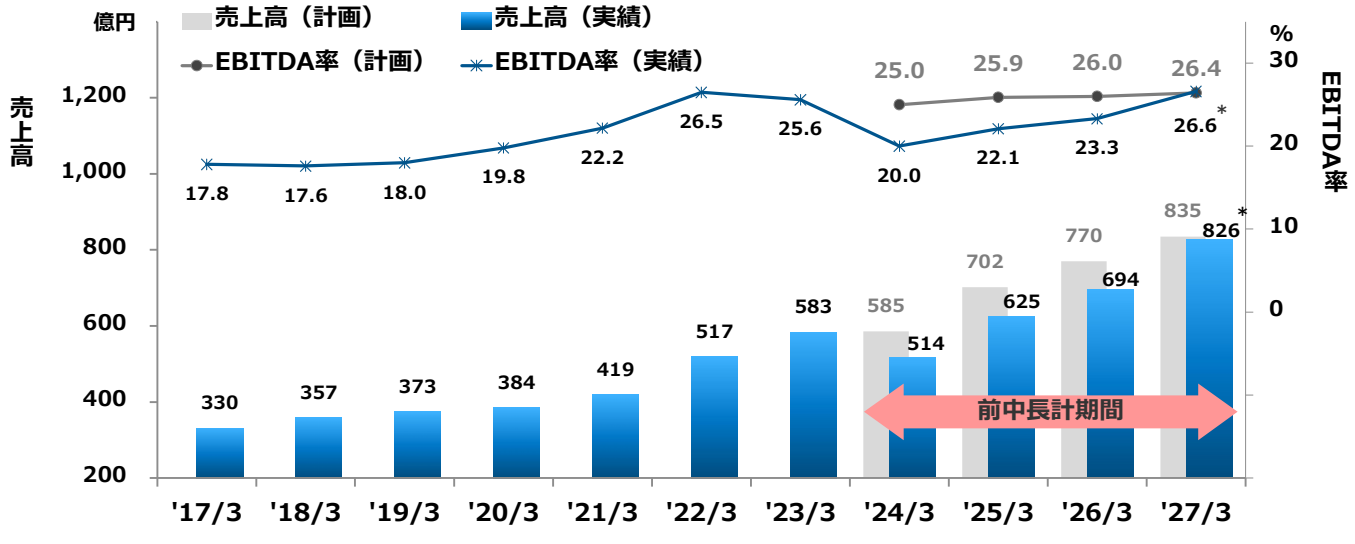
内容

- ▹ 中長期経営計画2023（前中長期経営計画）の総括　３頁～11頁
- ▹ 中長期経営計画2026（新中長期経営計画）　12頁～32頁

中長期経営計画2023（24年３月期～）の総括

前中長期経営計画の振返り（ハイライト）

◤ 前中計当初はコロナ特需の反動もあり、売上高、EBITDA率も落ち込んだが、AI・半導体需要の拡大を背景に回復し、2027年3月期では定量目標をほぼ達成できる見込み。



*2027年3月期：予想値（2026年11月5日）

前中長期経営計画の振返り（定量目標）

◤ 売上高、EBITDAマージンは、2027年3月期の定量目標をほぼ達成できる見込み

目標項目	2026年３月期（前中長計３年目）		2027年３月期（前中長計４年目）		
	前中長計2023	実績	前中長計2023(計画)	新中長計2026(計画)	現時点予想 11月５日開示
売上高	770	694	835	825	826
新規事業売上構成比	15.0%	4.3%	-	4.2%	4.2%
非半導体売上構成比	20.0%	16.6%	19.9%	15.3%	15.3%
非研磨分野売上構成比	8.0%	5.1%	-	3.9%	3.9%
EBITDAマージン[*1]	26.0%	23.3%	26.4%	26.2%[*3]	26.6%
ROE[*2]	15.0%	11.3%	15.0%	14.3%	14.7%

*1 EBITDAマージン＝（営業利益＋減価償却費）÷ 売上高 x 100
*2 ROE=当期純利益 ÷ 自己資本 x 100
*3 2026年10月9日開示時点では26.0%としたが、26.2%に修正

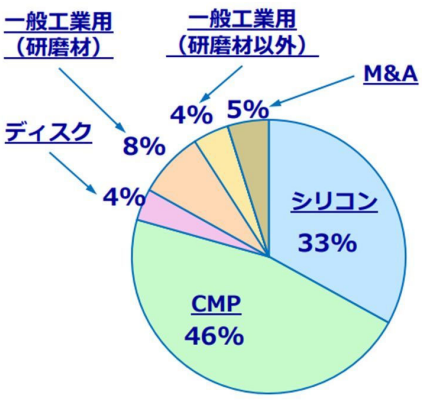
青字は達成　赤字は未達成

前中長期経営計画の振返り（用途別）

◤ CMPと一般工業用（非研磨材）は計画を上回り、シリコン、ディスク、一般工業用（研磨材）、M&Aは計画未達成

◤ 先端半導体向けで売上を拡大しているCMPの構成比が計画以上に大きくなっている

2026/3計画

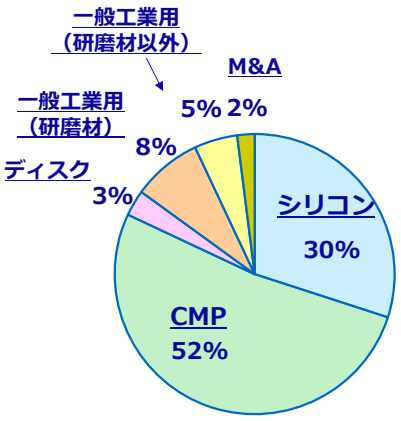


単位：億円（億円未満切捨て）

	74期 2026年3月期		
	前中長計	実績	差異
CMP	354	361	+7
シリコン	254	210	-44
ディスク	31	22	-9
一般工業用(研磨材)	62	51	-11
一般工業用(非研磨材)	31	34	+3
M&A	39	14	-25
合計	770	694	-76

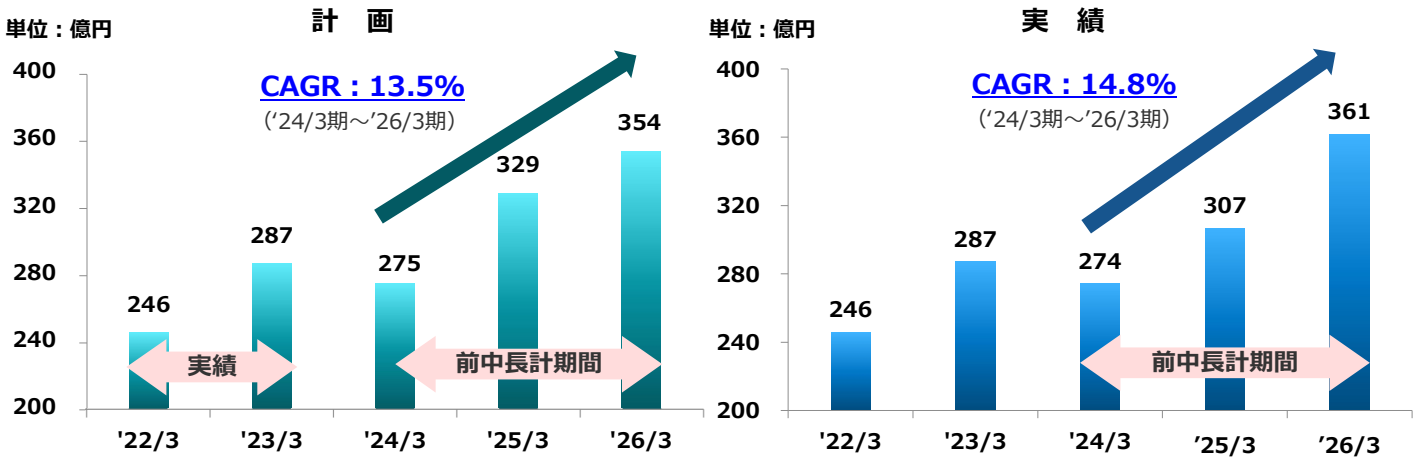
青字は達成　赤字は未達成

2026/3実績



前中長期経営計画の振返り（CMP）

◤ CMP製品売上は、ロジック、メモリともに先端半導体分野での採用が拡大し、
計画を上回る年率14.8%の成長を遂げた



各事業の取組みと成果

	区分	目指す姿	取組みの方向性	成果
半導体	CMP	世界トップのFEOLスラリーメーカー	先端顧客の期待に応える品質・技術の確立と日・米・台３拠点体制による強みの極大化	FEOLにおいて世界トップシェアを維持（当社推定50%超）
	実装基板	実装基板向け材料分野での事業機会獲得	先端パッケージ技術に対応した顧客密着型製品開発の推進	複数アプリケーションで当社製品の採用が決定、量産展開を推進
	シリコン	シリコンウェハー向け研磨材のリーディングカンパニー	独自技術の確立（原料設計、配合・精製技術）による顧客毎の研磨加工プロセスのソリューション提供	配合原料精製～設計を推進し、ラッピング、ポリシング分野では圧倒的な世界シェアを維持
	SiC	SiCパワー半導体向け研磨材の主要サプライヤー	コア技術を基盤とした新技術の確立と高効率性を有する製品投入によるマーケットシェアの拡大	採用進むもEV失速を受け市場立ち上がり遅れ。AI向けに大口径化等、顧客活動に沿った開発活動を継続

各事業の取組みと成果

	区分	目指す姿	取組みの方向性	成果
半導体	**溶射**	溶射材市場でのシェア拡大	複合技術を活用したソリューション提供による顧客価値の創造 （半導体）先端半導体製造装置向け製品の開発パートナー地位の確立 （非半導体）事業の柱となる未参入、新規の有望案件の発掘と獲得	・半導体関連、産業機械、自動車等、各分野向けのビジネス伸長 ・非レアアース材料による新規溶射材料を主要なお客様へ提案 ・リスク分散の為のサプライチェーンの立ち上げ着手
非半導体	**ディスク**	市場シェア奪回によるメインプレイヤーへの返り咲き	開発能力の強化と顧客への技術サポート体制の充実による製品競争力の強化	配合原料精製～設計を推進、更なるシェア拡大まであと一歩。市況回復もあり全体売上回復
非半導体	**研磨ソリューション**	研磨ソリューション領域での新規事業の創出	自動車用研磨コンパウンドを始め、お客様のウォンツに応える先進の研磨ソリューションの提供	①受託加工ビジネス立ち上げ ②AI需要に関わる、光電融合デバイス用化合物半導体スラリービジネスの獲得
非半導体	**先端技術・機能材料**	パウダー領域での新規事業の創出	独自の技術マーケティング力とパウダー技術を駆使した機能性材料（セラミックスパウダー、セラミックス複合材、新規パウダー等）の開発継続・事業化	顧客側で下記の新規パウダー技術・製品を評価中： ・熱伝導フィラー ・セラミックス複合材料 ・平板状あるいは丸棒状形状の新規パウダー ・３Dプリンター用超硬材料

前中長期経営計画　振返り：設備投資

- 旺盛な将来需要とリードタイムの長期化で発注前倒し、資材･建築費の高騰などで上回って推移
- 更にAI･半導体を中心とする需要対応で各務山工場の拡張、各務山工場隣接地及び台湾で工場新設、研究開発の為に最先端の設備･機器導入を行う為に、前中長期経営計画を大幅に上回る

【設備投資】

（億円）

	前中長計	実績/新中長計	差額
’23/4~’26/3 3カ年計画	300	388（実績）	+88
’26/4~’29/3 3カ年計画	250	850（新中長計）	+600
合計	550	1,238	+688

差異分析は28ページにて説明

前中長期経営計画　振返り：総括

- 売上高、EBITDAマージンは、2027年3月期でほぼ達成できる見込み
- 昨今AI・半導体を中心に需要は回復し、将来需要も旺盛な為、設備投資は「中長期経営計画2023」に対し、大幅な増加が見込まれる。又、**この設備投資は「中長期経営計画2026」より先の期間（2032年4月以降）での回収を見込む。**（建設・設置・客先評価期間を考慮）
- 「中長期経営計画2023」では自己資金で設備投資を行う計画であったが、設備投資が大幅に増加する為、不足分は**外部から資金調達が必要**

AI向け半導体の需要拡大、米国の関税強化や中国の輸出規制等の保護主義的な動向、米中対立・中東情勢の悪化などの地政学的リスクの高まり、円安の長期化とエネルギー価格・原材料価格など調達コストの上昇、人手不足や賃金上昇など当社を取り巻く環境の劇的な変化が大きな影響

今後６年間に亘る新たな計画を「中長期経営計画2026」として策定

中長期経営計画2026（27年３月期～）

基本方針

当社は、企業使命である「高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します」に基づき、既存事業（半導体関連事業等）の更なる拡大と新たな柱となる新規事業の創出を通じて、研磨材メーカーからパウダー＆サーフェスカンパニーへの進化を遂げ、持続可能な社会の実現への貢献を目指すことを基本方針としております。

2027年3月期から 2032 年3月期の6年間を対象とする本計画では、半導体向け当社製品への需要拡大に伴い、当社生産稼働が高水準で推移する中、将来の成長機会を確実に取り込み、お客様の中長期的な事業拡大を支える当社供給体制を構築すべく、需要が顕在化する前から、将来を見据えて先行的かつ継続的な生産・研究開発基盤の整備・拡充に一層の経営資源を投入します。

併せて、環境変化に対応できる強靭な経営基盤の構築、サステナブルな経営の根幹を成す人材投資やESGに係る取組みを積極的に推し進め、中長期企業ビジョン・スローガン「私たちは一人ひとりの前向きなアイデアとチャレンジを応援します」の実現に向け、各種施策等を策定いたしました。

環境分析

- 当計画期間中は、AIの高性能化や普及拡大に伴う半導体市場の伸長が期待される
- しかし、半導体市場は歴史的にシクリカルであり、当社の持続的な成長には非半導体分野の育成が重要

マクロ	半導体業界	当社への影響
AI・データセンター需要の拡大	▹ 先端ロジック・先端メモリの需要増と電力消費の急増 ▹ 前工程における微細化、後工程におけるチップの積層化や高密度接続等、技術の進展による半導体の高性能化 ▹ 大手半導体メーカーの生産能力増強投資が加速	▹ 最先端半導体の開発において、より高度化・多様化する顧客要求に迅速且つ的確に応える当社新製品開発体制の強化が必須 ▹ データセンターの省電力化に関わる、光電融合デバイス向け製品での需要拡大 ▹ 前工程における事業拡大および後工程における新規事業機会の拡大 ▹ 当社研磨材への需要も旺盛になる中、安定供給継続に資する更なる生産能力の増強が不可欠
地政学リスクの高まり	▹ グローバルサプライチェーンの不安定化 ▹ 原油価格高騰に起因する物価上昇	▹ 安定供給体制の強化が必須 ▹ 原材料・副資材・建設・エネルギー等に関連するコストの高騰
環境問題への対応	▹ 脱炭素社会の実現に向けたサプライチェーンの環境対応強化	▹ 環境規制の新設・改正に対する対応、国・地域ごとに異なる規制要件への対応が必須

新中長期経営計画（定量目標）

◤ 大規模投資（設備投資1,300億円）の実施に伴い、半導体市場の伸びを確実に取り込み収益を伸ばし、減価償却費の増加を吸収。利益確保

目標項目	実績 2026年 3月期	本計画1年目 2027年 3月期	本計画3年目 2029年 3月期	本計画6年目 2032年 3月期
連結売上高	694億円	825億円	1,040億円	1,380億円
新規事業売上高比率	4.3%	4.2%	11%	14%
営業利益率	19.9%	20.9%	20%	21%
EBITDAマージン	23.3%	* 26.2%	29%	31%
ROE	11.3%	14.3%	14%	17%

（売上高）
- ▹ 計画初年度からのCAGR9%
- ▹ 新規事業売上高比率14%を目指す

（収益性）
- ▹ 減価償却費と研究開発費の増加により、営業利益率は一時的に低下するもEBITDAマージンは上昇を目指す

（資本効率）
- ▹ ROEは2032年3月期、17%以上を目指す

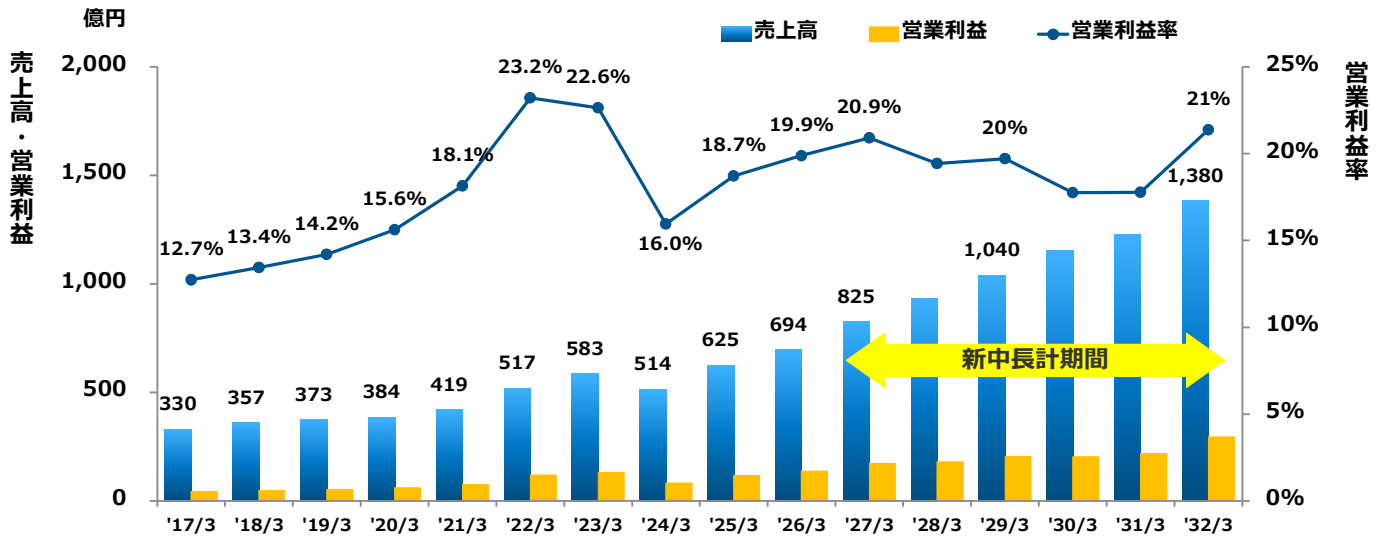
（配当方針）
- ▹ **連結配当性向55%以上**を目標
- ▹ **"配当維持または増配を行う累進配当"**（2029年3月期までの適用とするが、2030年3月期以降については、投資による持続的成長と株主還元の長期的な両立を実現できるよう検討）

*2026年10月9日開示時点では26.0%としたが、26.2%に修正

新中長期経営計画（ハイライト）

◤ 売上高は事業機会の確実な捕捉により、持続的な成長を遂げ、2032年3月期に1,380億円を目指す

◤ 営業利益率)は大型設備投資による減価償却費の増加に伴い一時的に低下するものの、2032年3月期には減価償却費の増加は落ち着き、営業利益率は再び上昇に転じる想定



重要施策

◤ 基本方針に基づき、本計画期間中に取り組む重要施策は以下のとおり

1. 研磨材メーカーからパウダー＆サーフェスカンパニーへの進化を実現する新規事業の創出

- ✓ 独自技術の強みを活かしたマーケティング体制の強化
- ✓ 機能性材料での独創的な高付加価値提供
- ✓ 加工ソリューション提供であらゆる表面創生を実現
- ✓ 新規事業の創出及び成長に必要な技術獲得に向けたM&Aの推進

2. 半導体関連事業の強靭な基盤構築と次世代半導体向け材料分野での圧倒的な地位確立

- ✓ 中長期的な半導体市場の拡大に対応するグローバルでの大型投資の実行と確実な立上げ
- ✓ 半導体プロセスの高度化に応える業界トップ水準の研究開発・品質保証力の維持・向上により、確実に最先端ビジネスを獲得
- ✓ 次世代半導体の高機能化・多機能化を実現する実装基板向け材料の開発と事業獲得
- ✓ 発展を続けるAI・半導体関連分野での新たな事業機会の探索・捕捉

3. コア技術の発展と新技術の開発

- ✓ コア技術（ろ過・分級・精製技術、パウダー技術、ケミカル技術）の更なる発展
- ✓ 顧客価値創造を実現する革新的新技術開発への挑戦

重要施策

4. 技術・データの融合と、戦略的SCMの高度化による、環境変化に強く進化し続ける経営基盤の構築

- ✓ 技術とデータの融合による、エンジニアリング力の強化とデータドリブンな業務・意思決定の変革へ向けた準備及び実行
- ✓ 地政学的リスクを考慮した戦略的SCMとリスクマネジメントの高度化による、サプライチェーンの強靭化と事業継続力の強化
- ✓ 事業環境の変化を先取りし、迅速かつ柔軟に対応できる組織能力と実行力の強化

5. 100年企業を実現するGRIT（※）な組織と人づくりへの挑戦

- ✓ ものづくりの誇りを次代に受け継ぐ、揺るぎないインテグリティマインドの確立
- ✓ 働きやすさ、働きがいを実感できる組織文化の醸成とウェルビーイングの実現
- ✓ お客様目線を実践するプロフェッショナルの育成
- ✓ 切磋琢磨する最高のチームワーク創出

6. サステナビリティ経営の実践（マテリアリティを意識した経営）

- ✓ 気候変動をはじめとした環境問題解決への積極的な貢献
- ✓ リスク管理・サプライチェーンマネジメントを軸とした事業継続力の強化
- ✓ グローバルな事業活動を支えるガバナンス体制の強化
- ✓ サステナビリティ向上に資する価値創造活動の推進

※ GRIT：困難な状態にも挫けることなく、目標に向かって最後までやり抜くこと

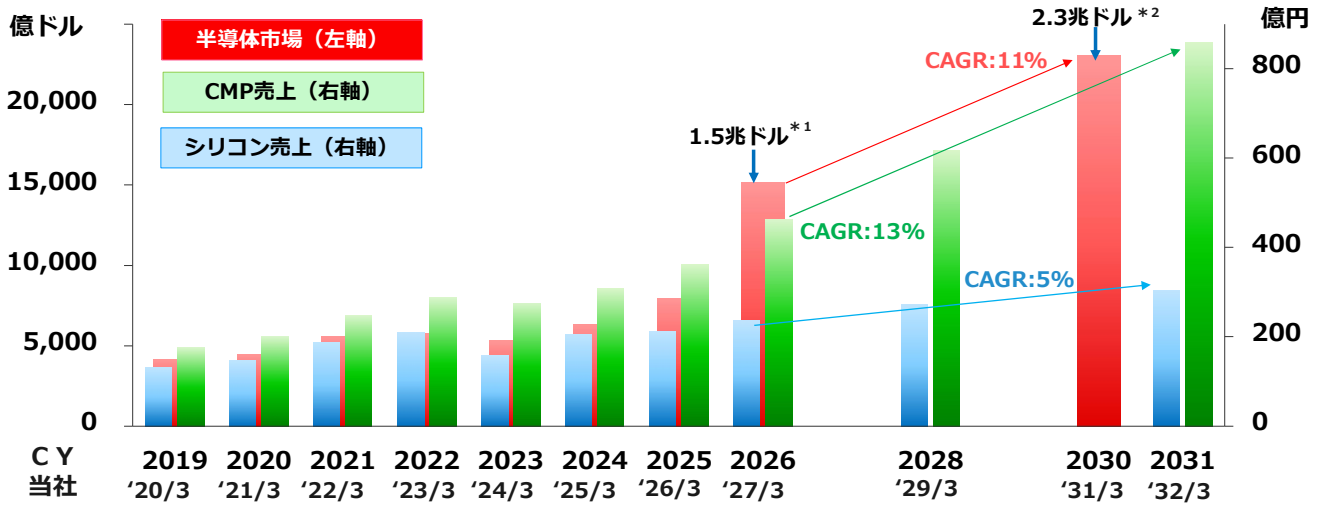
各事業の取組み

	区分	目指す姿	取組みの方向性
半導体	CMP（先端パッケージ含む）	FEOL用スラリーのマーケットリーダーに加え、先端パッケージング分野向けでも高いプレゼンスを確立	・顧客との関係深化による新規案件参画機会の拡大 ・当社独自技術の育成による開発基盤強化と顧客対応力向上
半導体	シリコン	半導体ウェハー向け研磨材のリーディングカンパニー	独自技術の確立（原料設計、配合・精製技術）による顧客毎の研磨加工プロセスのソリューション提供
半導体	溶射	・複合技術を活用し、顧客の最先端要求を実現 ・顧客へ価値提供するソリューション提案によって、溶射材市場のシェアを拡大	顧客ニーズを的確に把握する営業・マーケティング活動、顧客ニーズを迅速に実現する開発活動、リスク分散のためのサプライチェーンの構築、安定して供給し続ける生産活動により信頼を勝ち取る
非半導体	ディスク	市場シェア奪回による メインプレイヤーへの返り咲き	これまで培われた技術・ノウハウを背景に、配合原料設計と精製を通じた開発能力の強化
非半導体	研磨ソリューション	表面創成のベストソリューションによる事業拡大	顧客の表面創成ウォンツをいち早く捉え、精密研磨材メーカーの強みと、そこで培った研磨周辺技術・知見・ネットワークに磨きをかけ、研磨材と研磨・洗浄プロセスを組み合わせた独自のソリューションを提供
非半導体	先端技術・機能材料	パウダー技術を活用し、新しい価値をお客様へ提供することによって、新規事業を創出・育成	・パウダー技術の深堀と拡大を進めるとともに、顧客ニーズを的確に把握する営業＆マーケティング活動を推進 ・顧客ニーズに応えつつ、新規市場に対する新たなシーズ提案を継続的に実施

半導体市場・当社半導体関連事業

*1（出所）WSTS2026年6月2日
*2（出所）マッキンゼー2026年9月18日

- 半導体市場は、AI向けを成長ドライバーとして、2030年には2.3兆ドルを超える見通し
- 当社半導体向け製品については、顧客ごとに増産計画を調査し、当社使用量及び使用量の削減等を織り込み算出
- 半導体市場のCAGR11%（ CY2026～2030）に対し、当社CMP売上はCAGR13%、シリコン売上はCAGR５％（いずれも2027年3月期～2032年3月期）を想定

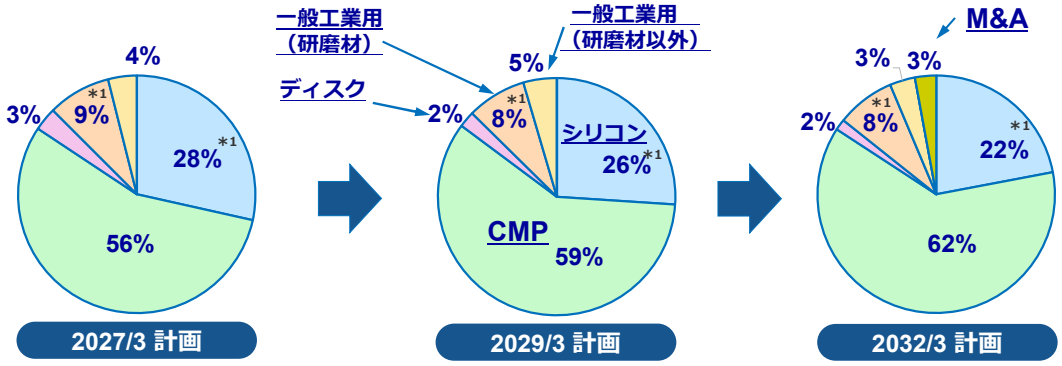


用途別売上高

	本計画１年目 2027年３月期計画	本計画３年目 2029年３月期計画	本計画６年目 2032年３月期計画
シリコン	235億円*1	271億円*1	304億円*1
CMP	461億円	615億円	858億円
ディスク	26億円	23億円	21億円
一般工業用(研磨材)	71億円*1	84億円*1	110億円*1
一般工業用(研磨材以外)	32億円	47億円	47億円
M&A*2	-	-	40億円

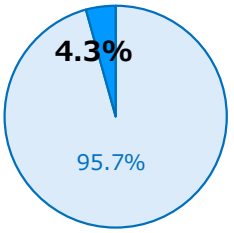
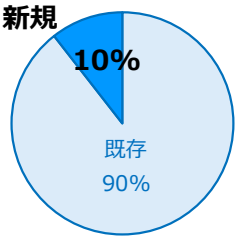
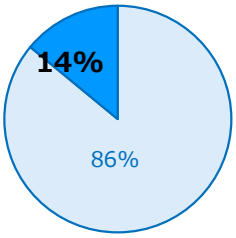
*1：シリコン・一般工業用（研磨材）の売上高については、決算開示の用途区分に合わせ、2026年10月9日開示から修正
（シリコン➡一般工業用（研磨材）各年度1%）

*２：2024年10月21日に株式取得した南興セラミックス株式会社については、M&Aでは計上せず、一般工業用（研磨材）にて集計



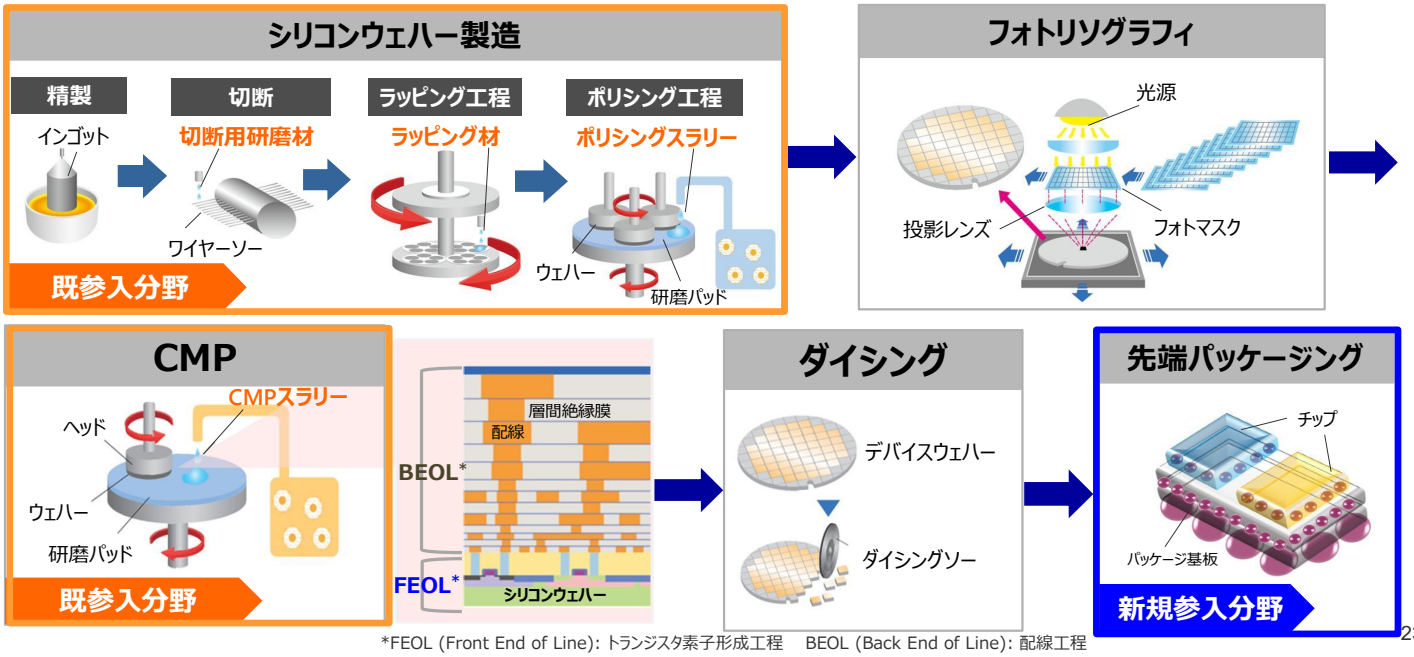
新規事業売上高構成比

◤ 創業以来培ってきた技術力をベースに事業環境変化に柔軟に対応し、新たな事業機会を確実に捉え、新規事業を着実に成長させていく

	‘26/3実績	‘29/3計画	‘32/3計画
新規事業			
成長ドライバー	▹ 半導体関連：先端パッケージング、光電融合デバイス向け ▹ 一般工業用 研磨材：自動車外装コンパウンド、受託加工 ▹ 一般工業用 非研磨材：セラミックスパウダー（高流動性、高放熱性、形状制御） セラミックス複合材（軽量、高耐熱性） ▹ M&A		

先端パッケージング向け研磨材（CMP）

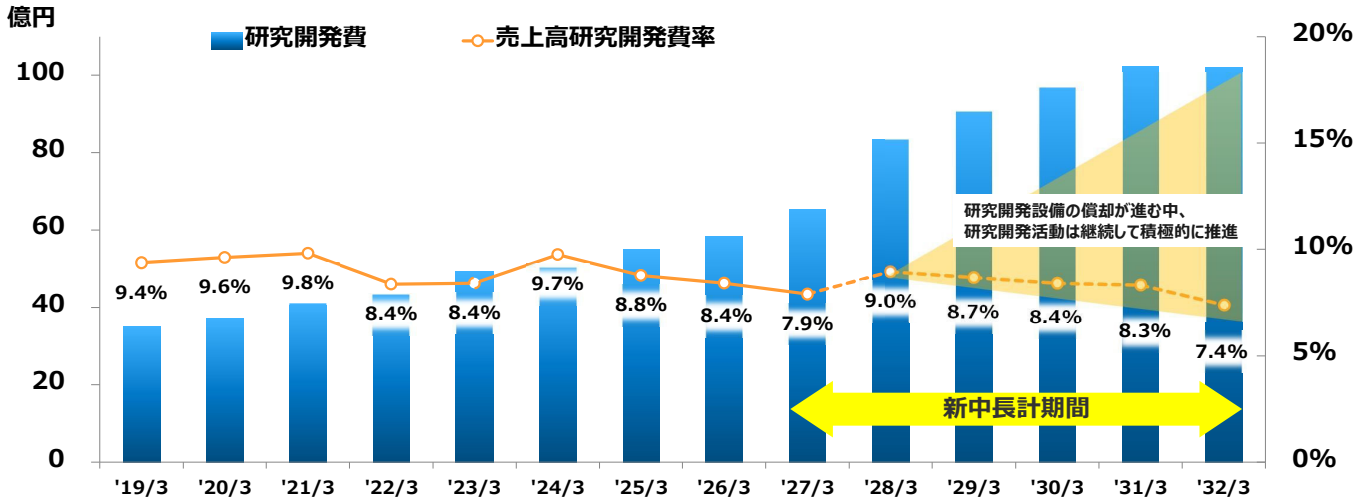
◤ シリコンウェハー製造、CMP工程に加え、新たに先端パッケージング分野に参入し、更なる飛躍を目指す



*FEOL (Front End of Line): トランジスタ素子形成工程　BEOL (Back End of Line): 配線工程

研究開発費

◤ 新中長計期間においても、研究人員の増員、次世代半導体の開発に追随するための研究開発施設拡張、最先端研究開発設備機器（評価装置、研磨装置他）導入、当社コア技術の強化及び新技術確立の中核となる新研究所の建設等に研究開発費を投下し顧客ニーズに対応する。ただし、過去10%弱であった売上高研究開発費比率は売上増加に伴い8%近傍で推移。



大型投資計画

◤ 世界各国が半導体を戦略物資とみなし、その地産地消を目指して大規模な投資、生産を進める流れに対し、当社は日・米・台３拠点の開発、製造、品質保証体制で対応

◤ **フジミインコーポレーテッド（岐阜県）**
- 各務山工場フェーズ２生産設備導入（CMP、シリコン用スラリー）
- 各務山工場隣接地に新工場建設（　〃　）
- 既存工場増設による生産能力増強（　〃　）
- 老朽施設の改修とともに事業構造転換を推進
- 第２開発センター（名称「イノベーションセンター」）建設（主に新規事業開発向け）



◤ **フジミ台湾（苗栗県）**
- 新工場の建設（CMP用スラリー）
  - 台湾半導体デバイスメーカーの次世代最先端半導体製造能力増強に対応
  - 米国向け一部製品をカバー

◤ **フジミコーポレーション（オレゴン州）**
- 新工場棟建設（CMP用スラリー）
  - 米国内の米国、台湾半導体デバイスメーカーの最先端半導体製造能力増強に対応

投資計画

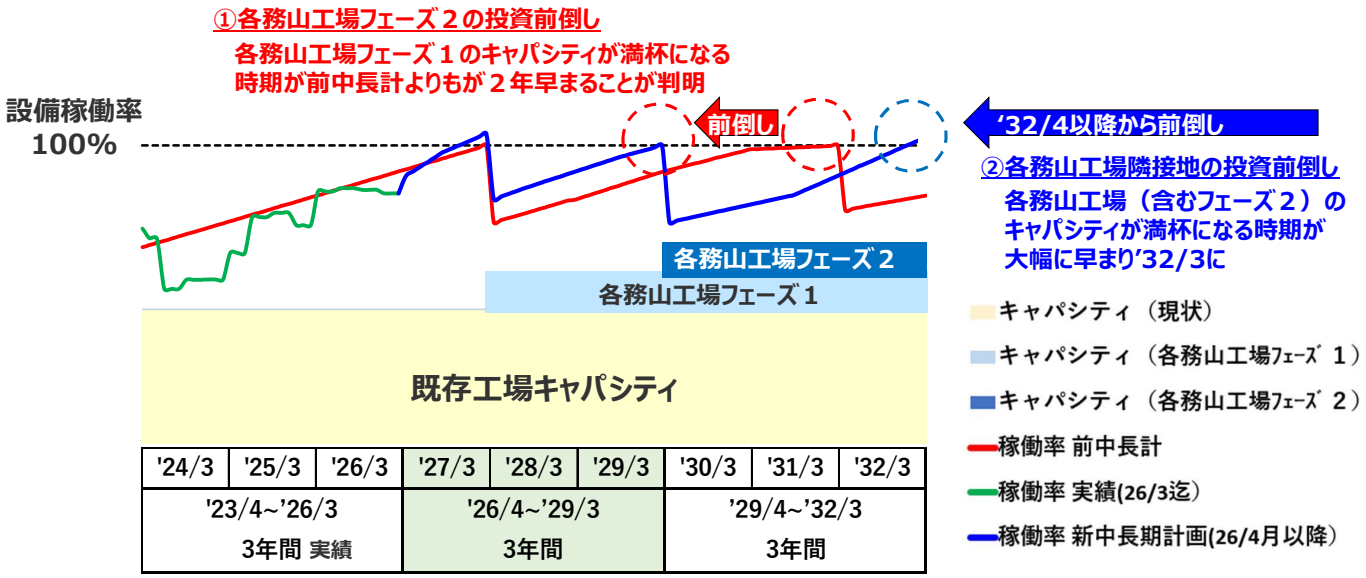
◤ 今後においても、半導体市場ではAIをはじめとする先端分野を中心に、市場拡大と技術の高度化が続くことが見込まれ、このような将来の成長機会を確実に取り込み、お客様の中長期的な事業拡大を支える供給体制を構築するためには、需要が顕在化してから対応するのではなく、将来を見据えて先行的かつ継続的に生産・研究開発基盤を整備していくことが極めて重要

◤ 本計画における設備投資は、単なる足元の需要増加への対応ではなく、将来に亘り安定供給責任を果たすとともに、当社の技術競争力を維持・強化し、**中長期的な成長を実現していくために不可欠な戦略的投資**と位置付け

	‘24/3～’26/3 3カ年累計（実績）	‘27/3～’32/3 6カ年累計 （計画）		
			‘27/3～’29/3 3カ年累計	‘30/3～’32/3 3カ年累計
設備投資	388億円	1,300億円	850億円	450億円

中長期的に増加する需要と稼働率

- 2027年3月期までは既存工場の設備稼働率を高めて需要に対応。
- 2028年3月期に各務山工場フェーズ１が稼働開始し稼働率は一旦落ち着く。
- 前中長計に対し2028年3月期以降の需要が大きく増加の為に、各務山工場フェーズ２着手等前倒し投資が必要。



設備投資　差異分析

- 旺盛な将来需要とリードタイムの長期化で発注前倒し、工場及び第2開発センターの建設コストの高騰等で上回る
- 更にAI・半導体を中心とする需要対応で各務山工場の拡張、各務山工場隣接地及び台湾で工場新設、研究開発で最先端の設備・機器導入を行う為に、前中長期経営計画を大幅に上回る

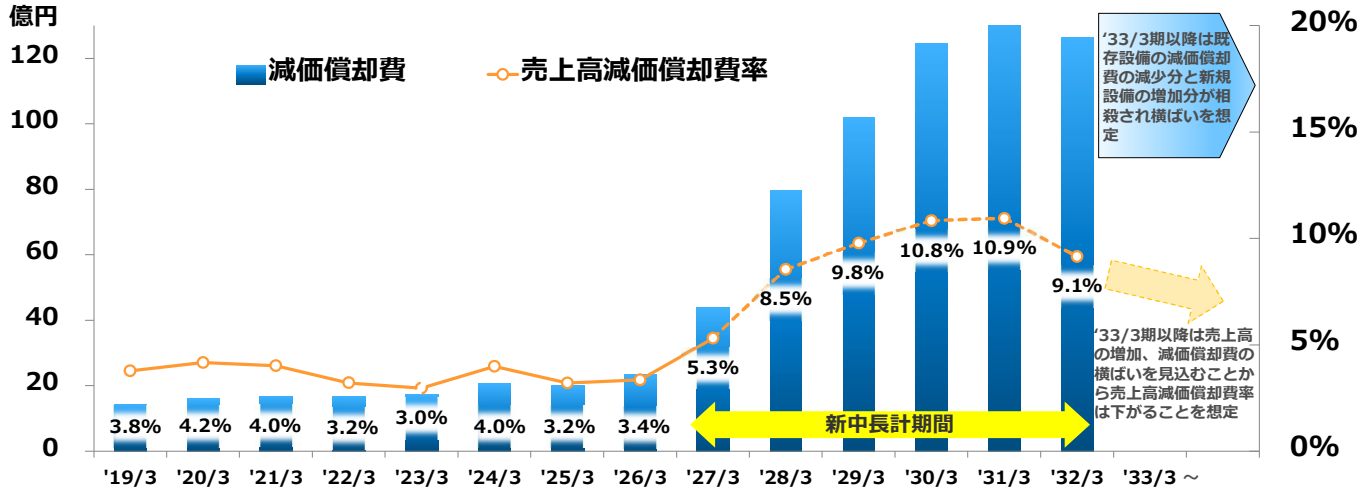
【設備投資】

（億円）

	前中長計	実績/新中長計	差額	要因	
'23/4~'26/3 3カ年計画	300	388 (実績)	+88	①需要増・リードタイム長期化により工場建設の前倒し ②製造設備の高機能化（先端半導体対応） ③工場及び第2開発センターの建設コスト高騰の影響 ④その他設備投資の見直し・減額	+40 +30 +50 △30
'26/4~'29/3 3カ年計画	250	850 (新中長計)	+600	①2026/3以前への工場建設の前倒し ②2029/4以降の工場建設前倒し ③需要増加による台湾新工場の追加新設 ④導入設備の高機能化、効率化、IT、工場再編等	△40 +170 +200 +270
合計	550	1,238	+688		

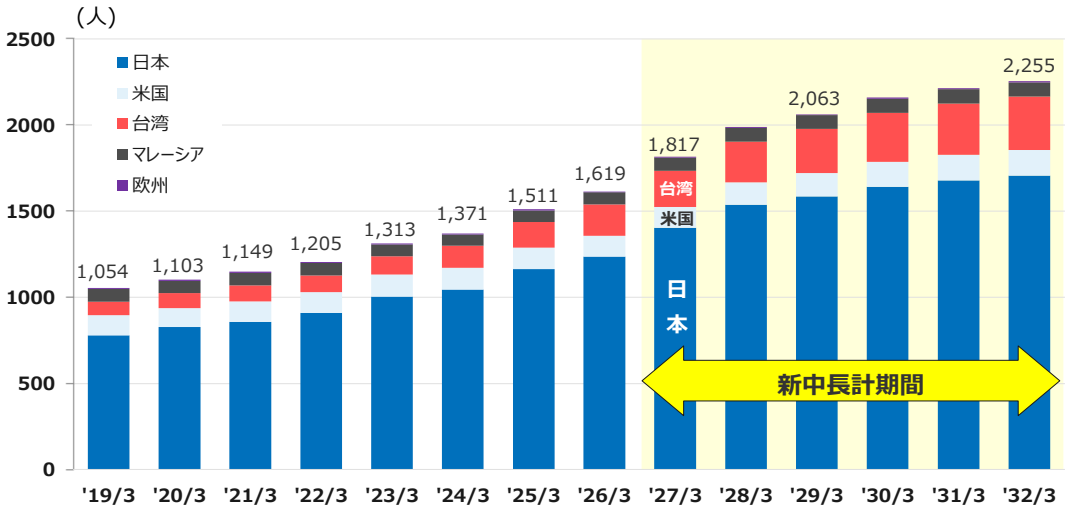
減価償却費

- 3%～5%で推移していた売上高減価償却費率は、①グローバルで安定的な製品供給体制の拡充のための新工場建設・生産能力増強、②次世代半導体の開発に追随するための研究開発施設拡張、③最先端研究開発設備機器（評価装置、研磨装置他）導入、④当社コア技術の強化及び新技術確立の中核となる新研究所の建設等により、2027年3月期以降大きく上昇
- 2033年3月期以降は、既存設備の減価償却費の減少分と新規設備の増加分が相殺され概ね横ばいの見通し



従業員数および人員計画

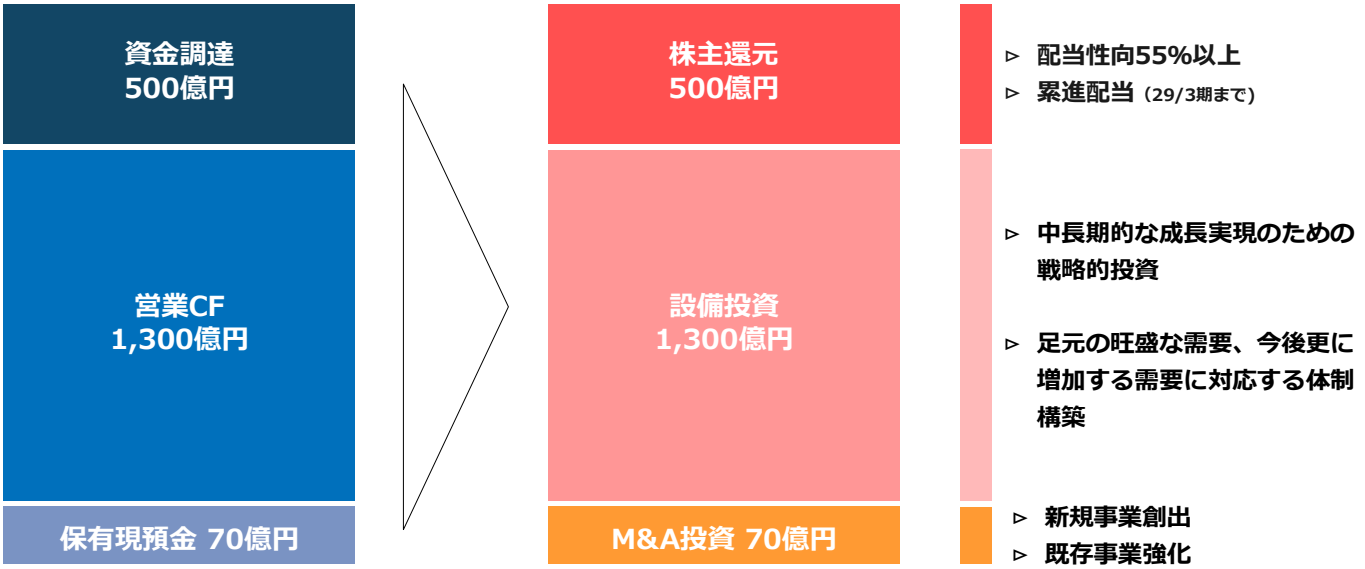
- 事業拡大を目指し新工場建設を予定している日本・台湾で増員
- 新規事業を獲得すべく研究開発（日・米・台）でも増員



＊上記従業員数には、臨時雇用者（嘱託、パートタイマー、人材会社からの派遣社員）が含まれております。臨時雇用者数は年間の平均人員数となります。

資金配分イメージ（6年間累計）

◤ 伸びゆく営業CFと資本コストを意識した資金調達により、足元の需要増加・中長期的な成長に対応する**戦略的投資と株主還元の長期的な両立**を実現

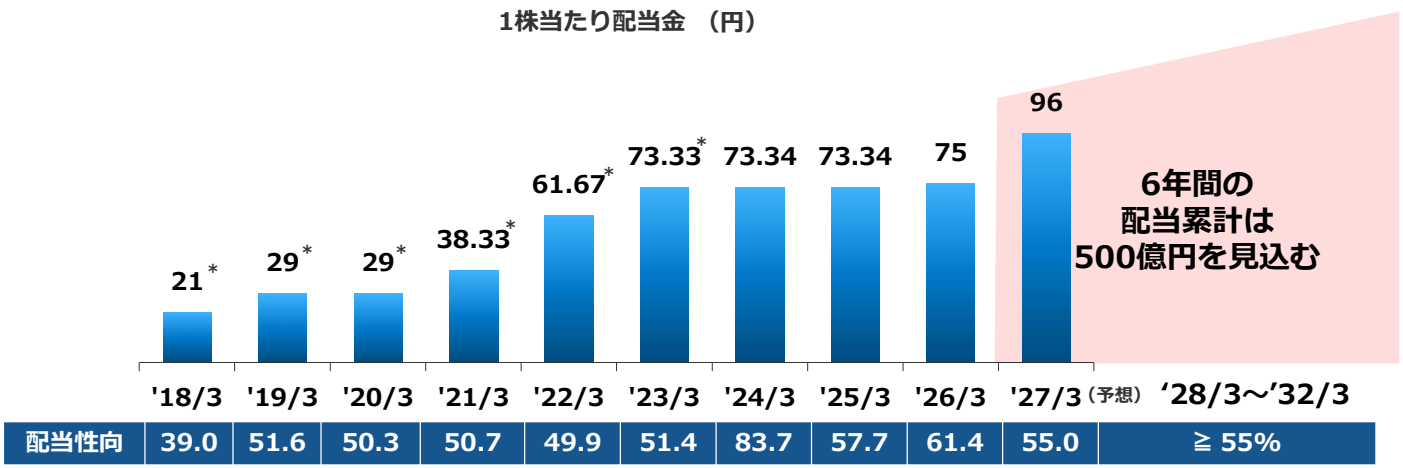


株主還元

◤ 業績に応じた積極的な株主還元：**連結配当性向 55%以上を目標**

◤ 安定配当の継続：**”配当維持または増配を行う”累進配当**を2029/3期まで適用

2030年3月期以降については、投資による持続的成長と株主還元の長期的な両立の実現に向け検討を行う



	'18/3	'19/3	'20/3	'21/3	'22/3	'23/3	'24/3	'25/3	'26/3	'27/3（予想）	‘28/3～’32/3
配当性向	39.0	51.6	50.3	50.7	49.9	51.4	83.7	57.7	61.4	55.0	≧ 55%

*当社は、2023年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合をもって株式分割を行っており、
2023年3月期以前の1株当たり配当金においても当該株式分割が行われたと仮定して記載しております。

技術を磨き、心をつなぐ

FUJIMI INCORPORATED